

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/obudowa-cte-t500-full-tower-argb-14cmx3-tempered-glassx2-snow-p-115417.html>



Obudowa CTE T500 Full Tower ARGB 14cmx3 Tempered Glassx2 - Snow

Cena brutto	840,99 zł
Cena netto	683,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KOTTKOB0T500001
Kod producenta	CA-1X8-00F6WN-01
Kod EAN	4713227537223
Producent	Thermaltake
Maksymalna długość karty graficznej	385
Gwarancja	36 mc.
Typ obudowy	Midi Tower
Moc zasilacza	Brak
Format obudowy	Mini-ATX
Złącza na przednim panelu	1 x mikrofon
Pozostałe parametry	Wsparcie wentylatorów Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right: 1 x 120mm, 1 x 140mm Rear: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Bottom: 1
Wymiary	615 x 275 x 516 mm
Waga	15.3
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	195
Opcjonalne chłodzenie wodne	1 x 120 mm (przód)
Maksymalna ilość wentylatorów	11
Zainstalowane wentylatory	1 x 140 mm RGB (przód)
Liczba zainstalowanych wentylatorów	3
Podświetlenie obudowy	ARGB
Panel boczny	Szkoło hartowane

Opis produktu

CTE T500 TG ARGB Snow Full Tower Chassis

CTE T500 TG ARGB Snow to specjalnie zaprojektowana obudowa typu full tower E-ATX z nowej serii CTE, zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoki poziom wydajności cieplnej krytycznym komponentom. Jest wyposażony w trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory 140 mm CT140 ARGB White i może obsługiwać radiator AIO o średnicy do 420 mm z przodu i maksymalnie 360 mm radiator AIO z tyłu.

Współczynnik kształtu CTE

Zaprojektowane przez Thermaltake

Współczynnik kształtu CTE zaprojektowany przez Thermaltake oznacza scentralizowaną efektywność cieplną i koncentruje się na zapewnieniu wysokiego poziomu wydajności cieplnej krytycznych komponentów. Konstrukcja wykorzystuje obrót płyty głównej o 90 stopni, zapewniając bardziej wydajne ścieżki przepływu powietrza.

Ponieważ procesor został przesunięty znacznie bliżej panelu przedniego, a karta graficzna bliżej panelu tylnego, zapewnione jest niezależne doprowadzenie zimnego powietrza w celu rozpraszania ciepła odpowiednio procesora i karty graficznej. To ogólne podejście umożliwiło firmie CTE zapewnienie lepszego i bardziej wydajnego przepływu powietrza wlotowego poprzez rozmieszczenie głównych komponentów i chłodzenie, a także optymalizację odprowadzania ciepła z systemu.

Przesuń krytyczne źródła ciepła (procesor i karty graficzne) bliżej chłodnego powietrza

Ponieważ procesor CTE T500 został przesunięty znacznie bliżej panelu przedniego, a karta graficzna bliżej panelu tylnego, zapewnione jest niezależne doprowadzenie zimnego powietrza w celu rozpraszania ciepła odpowiednio procesora i karty graficznej.

Aktywne chłodzenie dla bardziej wydajnego przepływu powietrza dolotowego

To ogólne podejście umożliwiło CTE T500 zapewnienie lepszego i bardziej wydajnego przepływu powietrza wlotowego poprzez rozmieszczenie głównych komponentów i chłodzenie, a także optymalizację odprowadzania ciepła z systemu.

Poznaj idealne połączenie designu i wydajności dzięki naszemu CTE T500

CTE T500 TG ARGB Snow to specjalnie zaprojektowana obudowa typu full tower E-ATX z nowej serii CTE, zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoki poziom wydajności cieplnej krytycznym komponentom. Jest wyposażony w trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory 140 mm CT140 ARGB White i może obsługiwać maksymalnie radiator AIO 420 mm z przodu i maksymalnie dwa radiatory AIO 360 mm z przodu i z tyłu. Jest mnóstwo miejsca na zainstalowanie elementów chłodzących, w tym przedniego i tylnego wspornika wentylatora, górnego i prawego otworu wentylacyjnego wentylatora, dolnego otworu wentylacyjnego wentylatora i otworu wentylacyjnego na osłonie, a w obudowie można zainstalować maksymalnie jedenaście wentylatorów 140 mm/120 mm. Inne ciekawe detale obejmują wyjmowane filtry, wspornik pompy i zbiornika oraz paski na rzepy ułatwiające zarządzanie kablami. Nasz CTE T500 Snow to idealny wybór, niezależnie od tego, czy szukasz niestandardowej konfiguracji chłodzenia cieczą, czy podwójnego systemu konfiguracji AIO!

Stwórz i pokaż swoją wymarzoną konstrukcję

Zaprojektowany, aby sprostać potrzebom zarówno rozwiązań typu wszystko w jednym, jak i niestandardowych rozwiązań chłodzenia cieczą, wszechstronne wnętrze CTE T500 TG ARGB jest wyposażone w dwa panele ze szkła hartowanego o grubości 4 mm z przodu i po lewej stronie, dzięki czemu użytkownicy mogą oglądać i podziwiać wszystkie komponenty w pełnej kolorystyce RGB chwała.

Obsługa podwójnych grzejników 360 mm

Nasz CTE T500 TG ARGB Snow oferuje doskonałe wsparcie chłodzenia dla entuzjastów niestandardowego chłodzenia cieczą, umożliwiając użytkownikom zainstalowanie do dwóch grzejników 360 mm jednocześnie z przodu i z tyłu. Aby zapewnić kompatybilność z AIO, użytkownicy mogą zainstalować maksymalnie jeden radiator AIO 420 mm z przodu i maksymalnie dwa radiatory AIO 360 mm z przodu i z tyłu.

Zmieszczą się wszystkie Twoje wymarzone komponenty chłodzące!

Obudowa CTE T500 Full Tower ma ogromną pojemność instalacji wentylatorów i chłodnic: do jedenastu wentylatorów 140 mm/120 mm i chłodnic AIO 360 mm w różnych miejscach (chłodnica AIO 420 mm z przodu). Co więcej, wyposażone wsporniki wentylatorów z przodu i z tyłu oraz miejsca montażowe u góry, po prawej stronie i na pokrywie zapewniają łatwy montaż wszystkich pożądanych elementów chłodzących.

Rozwał swój świat dzięki trzem fabrycznie zainstalowanym białym wentylatorom 140 mm CT140 ARGB

Obudowa CTE T500 TG ARGB Snow Full Tower jest wyposażona w trzy białe wentylatory ARGB PWM 140 mm z przodu, u góry i z tyłu. Efektami świetlnymi LED można manipulować za pomocą oprogramowania obsługiwanego przez płytę główną. Użytkownicy mogą stworzyć niesamowity pokaz oświetlenia RGB, jednocześnie ciesząc się najwyższą wydajnością chłodzenia.

Wszystko przetestowaliśmy, więc Ty nie musisz

W Thermaltake zawsze poddajemy nasze produkty testom obciążeniowym w trudnych warunkach, aby zapewnić jakość produktu. Produkty CTE T500 TG ARGB Snow Full Tower Chassis zostały przetestowane przy 100% pełnym obciążeniu przez 30 minut, z najwyższej klasy procesorem, procesorem graficznym i płytą główną w momencie testu, w porównaniu z konfiguracją w stylu konsumenckim, co pozwoliło nam aby przetestować, jak podwozie radzi sobie w rzeczywistych sytuacjach.

- Typ obudowy: Midi Tower
- Format obudowy: Mini-ATX

- Panel boczny: Szkło hartowane
- Podświetlenie obudowy: ARGB
- Moc zasilacza: Brak
- Liczba zainstalowanych wentylatorów: 3
- Zainstalowane wentylatory: 1 x 140 mm RGB (przód)
- Maksymalna ilość wentylatorów: 11
- Opcjonalne chłodzenie wodne: 1 x 120 mm (przód)
- Złącza na przednim panelu: 1 x mikrofon
- Maksymalna długość karty graficznej: 385
- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 195
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Wymiary: 615 x 275 x 516 mm
- Waga: 15.3
- Pozostałe parametry: Wsparcie wentylatorów Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right: 1 x 120mm, 1 x 140mm Rear: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Bottom: 1 x 120mm, 1 x 140mm PSU Cover: 1 x 120mm, 1 x 140mm Wielkość chłodnicy Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm(AIO only), 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 120mm(AIO only) Rear: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm
- Gwarancja: 36 mc.